

H20年度 要素試験

< 目次 >

課題番号	課題名	区分	頁	試験時間	課題番号	課題名	区分	頁	試験時間	
1	バックラインディング工程および ダイシング工程(1/3) サンプル	問題	2	10分	5	端子形成工程およびマーキング工程(1/3)	問題	26	10分	
		解答	3				解答	27		
	バックラインディング工程および ダイシング工程(2/3) サンプル	問題	4			問題	28			
		解答	5			解答	29			
バックラインディング工程および ダイシング工程(3/3)	問題	6	問題	30						
	解答	7	解答	31						
2	タイボンディング工程(1/3) サンプル	問題	8	10分	6	パッケージ(1/1)	問題	32	10分	
		解答	9				解答	33		
	タイボンディング工程(2/3)	問題	10		7	IC(集積回路)組立工程(1) (1/3)	問題	34	10分	
		解答	11				解答	35		
タイボンディング工程(3/3)	問題	12	IC(集積回路)組立工程(1) (2/3)	問題		36				
	解答	13	解答	37						
3	ワイヤボンディング工程(1/3)	問題	14	10分	8	IC(集積回路)組立工程(2) (1/1)	問題	40	10分	
		解答	15				9	安全衛生(1/3)		問題
	問題	16	安全衛生(2/3)							問題
	解答	17	安全衛生(3/3)		問題	43				
ワイヤボンディング工程(2/3)	問題	18	安全衛生	解答	44					
	解答	19	合計90分							
4	封止工程(1/3)	問題	20	10分						
		解答	21							
	封止工程(2/3)	問題	22							
		解答	23							
封止工程(3/3)	問題	24								
	解答	25								

実際の問題と解答は語群に記号で付記されていますが、利用者の便宜を図るため

本資料では文章解答を多用して記載しています。

解答は問題文の次のページに記載しています。印刷して勉強される場合、別紙すると便利です。

SAMPLE

課題1. バックグラインディング工程およびダイシング工程 (1/3)

問1) 写真を3枚示す。ダイシング工程における不良を示している。それぞれに当てはまる 不良名称 不良原因 対策 を語群から一つずつ選んでください。ただし同じ語句を使ってはいけません。

写真1

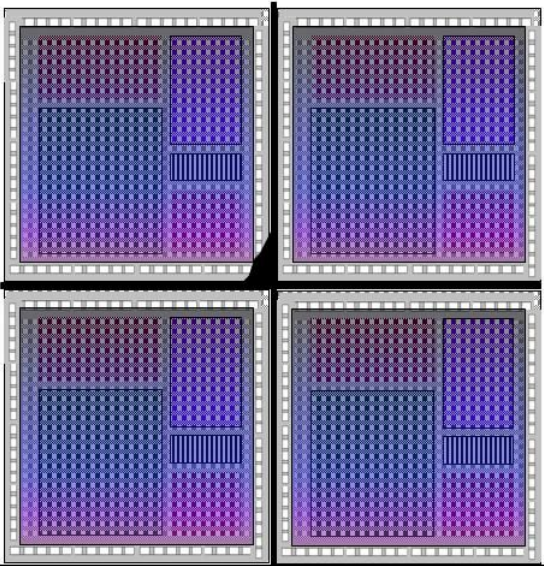


写真2

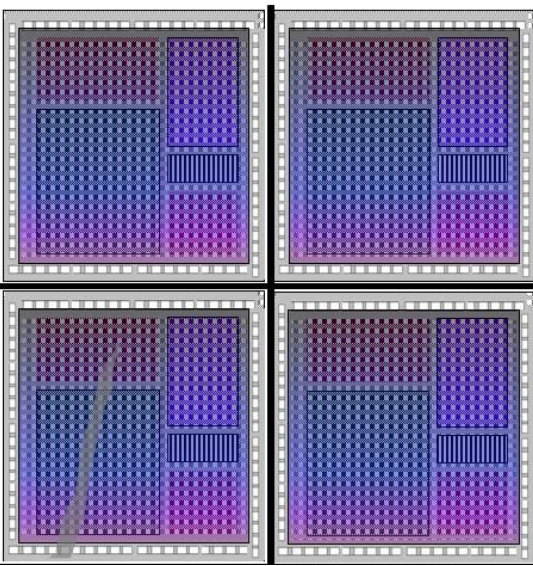
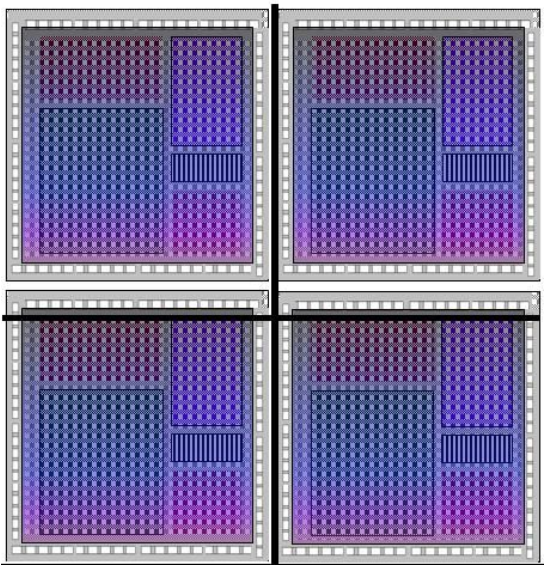


写真3



語群		
不良名称	不良原因	対策
パッド変色	ブレード摩耗による切断不良	作業方法の指導
チッピング	洗浄水の汚染	ダイサ認識調整やデータ見直し
切断位置ズレ	ダイサのパターン認識ミス	ブレード交換またはブレードドレッシング
スクラッチ	ハンドリングミス	微粒フィルタの設置

SAMPLE

課題1. バックグラインディング工程およびダイシング工程 (1/3)

問1) 写真を3枚示す。ダイシング工程における不良を示している。それぞれに当てはまる 不良名称 不良原因 対策を語群から一つずつ選んでください。ただし同じ語句を使ってはいけません。

写真1

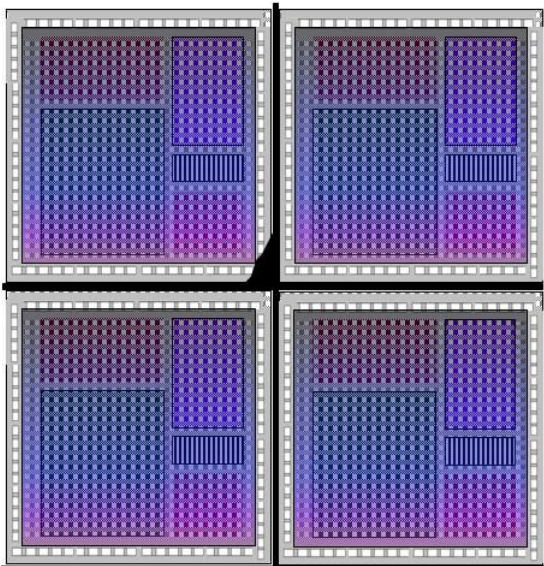


写真2

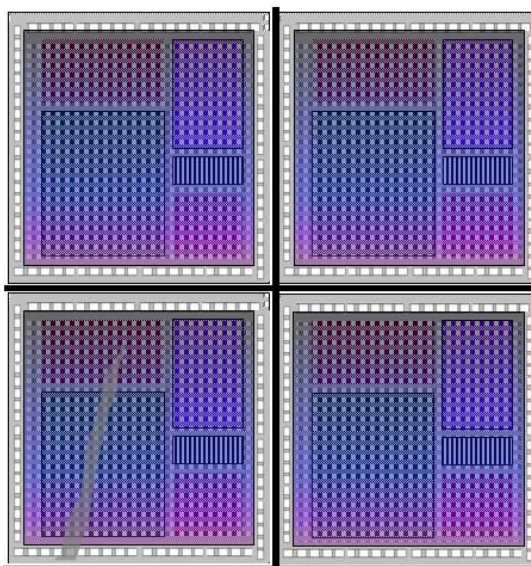
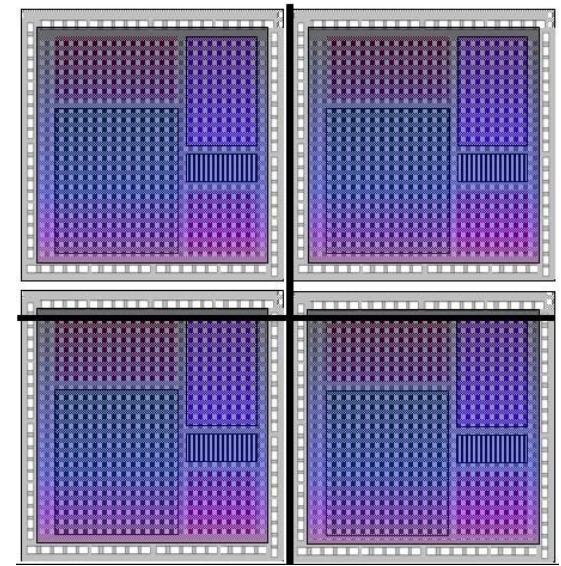


写真3



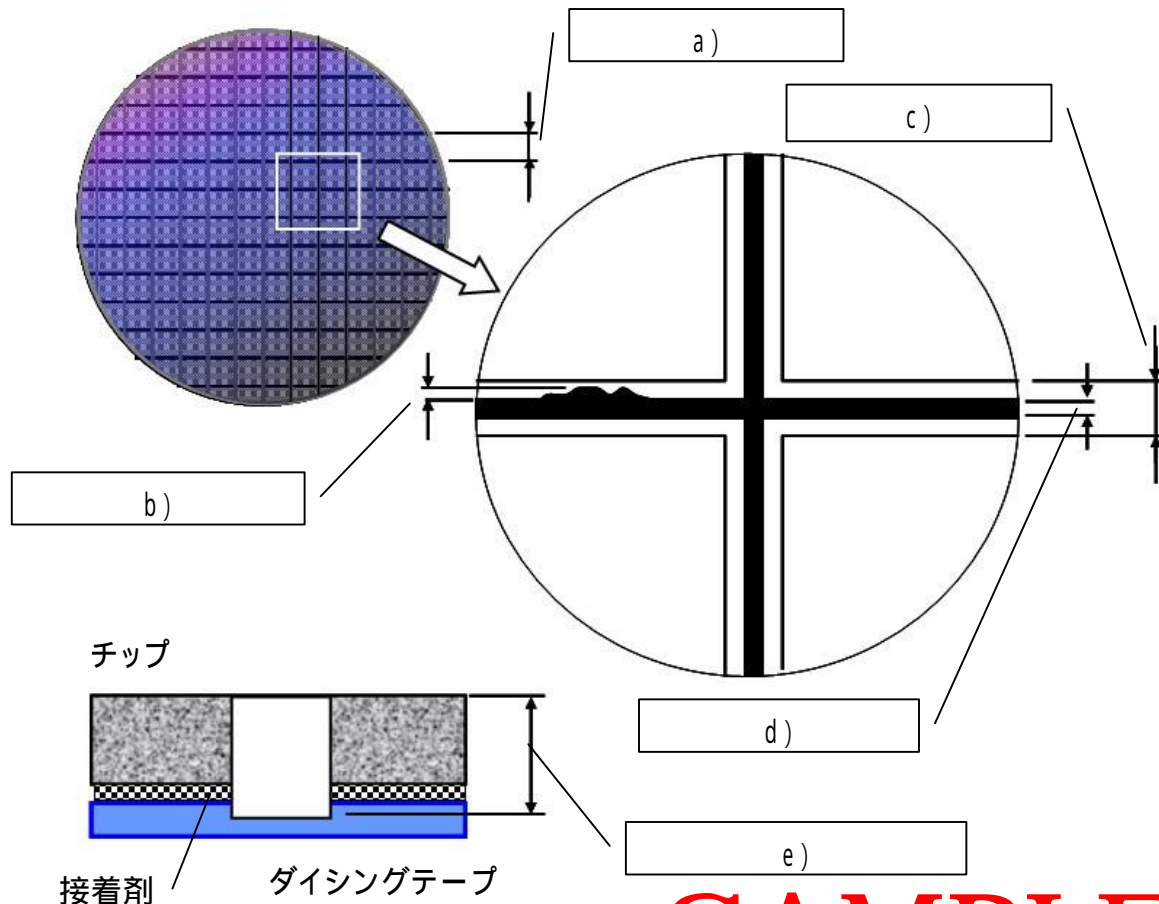
語群

写真	不良名称	不良原因	対策
1	チッピング	ブレード摩耗による切断不良	ブレード交換またはブレードドレッシング
2	スクラッチ	ハンドリングミス	作業方法の指導
3	切断位置ズレ	ダイサのパターン認識ミス	ダイサ認識調整やデータ見直し

SAMPLE

課題1. バックグラインディング工程およびダイシング工程 (2/3)

問2) 図はダイシングにおける切断部を示したものである。それぞれの記号に対応する語句を選びなさい。
ただし同じ語句を使ってはいけません。

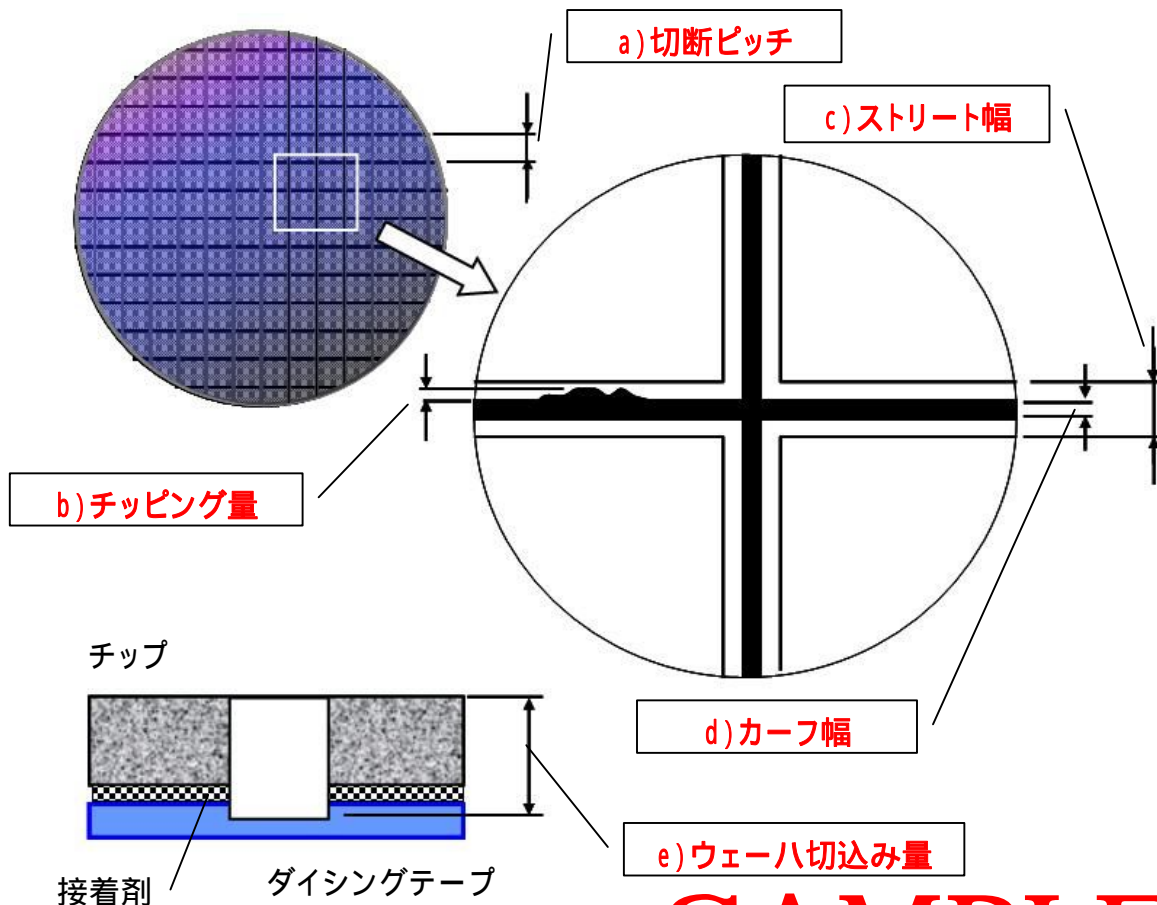


語群
ウェーハ切込み量
カーフ幅
切断ピッチ
ストリート幅
チップング

SAMPLE

課題1. バックグラインディング工程およびダイシング工程 (2/3)

問2) 図はダイシングにおける切断部を示したものである。それぞれの記号に対応する語句を選びなさい。
ただし同じ語句を使ってはいけません。



語群
ウェーハ切込み量
カーフ幅
切断ピッチ
ストリート幅
チッピング

SAMPLE

課題2. ダイボンディング工程 (1/3)

問1) ダイボンディング工程における写真を5枚示す。それぞれに当てはまる 不良名称 原因工程 発生原因 を語群から選んで下さい。ただし、 は同じ語句を選んではいけません。 は重複してもよい。

写真1

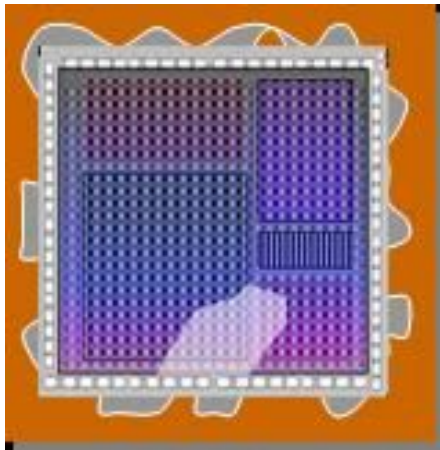


写真2

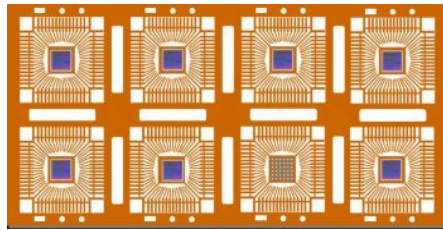


写真3

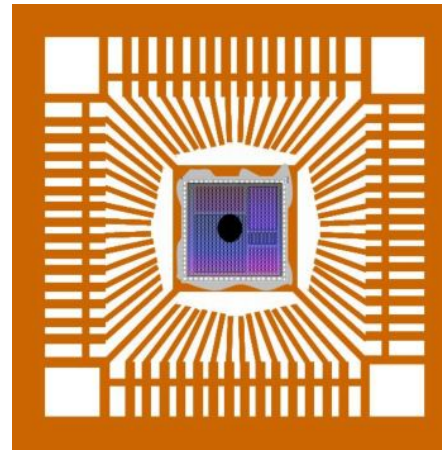


写真4

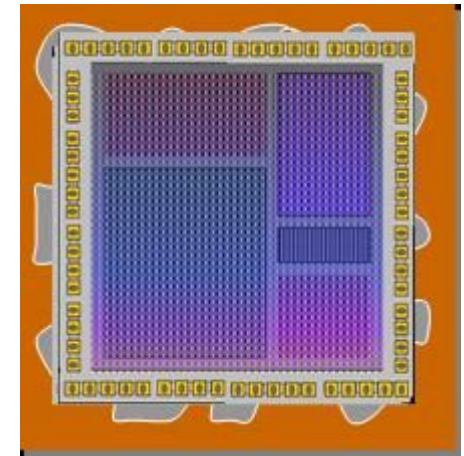
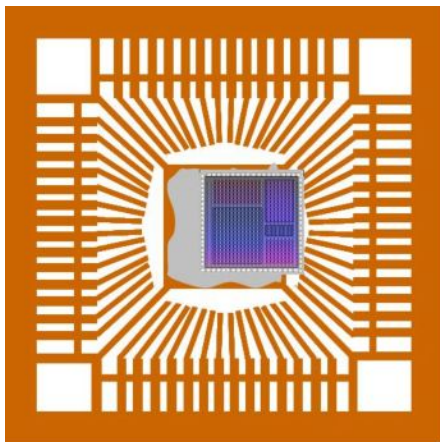


写真5



語群

不良名称	原因工程	発生原因
不良チップマウント	自工程	ダイシング洗浄異常
パッド汚染	他工程	フレーム搬送ミス
チップずれ		接着剤のバリ付着
DAF付着		チップの吸着エラー
チップなし		不良マーク認識ミス

SAMPLE

課題2. ダイボンディング工程 (1/3)

問1) ダイボンディング工程における写真を5枚示す。それぞれに当てはまる 不良名称 原因工程 発生原因 を語群から選んで下さい。ただし、 は同じ語句を選んではいけません。 は重複してもよい。

写真1

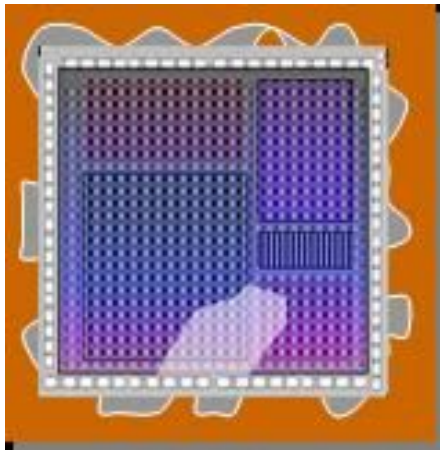


写真2

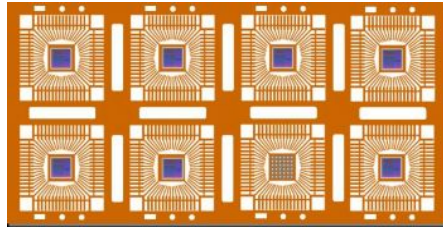


写真3

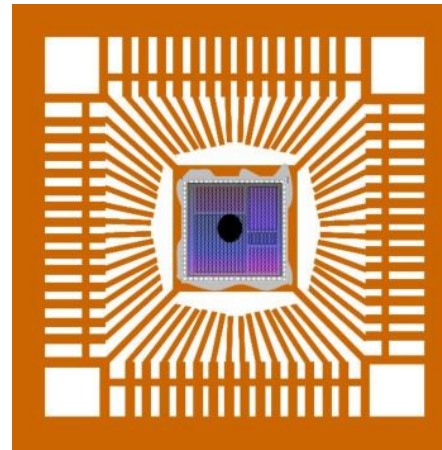


写真4

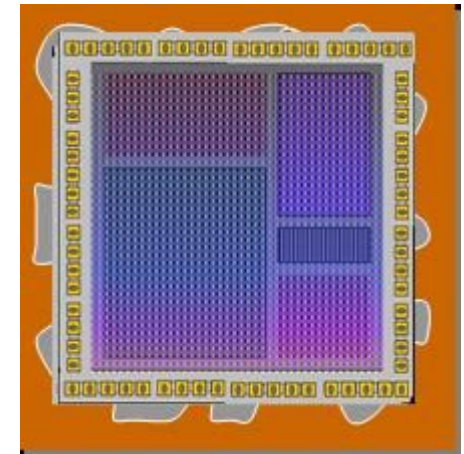
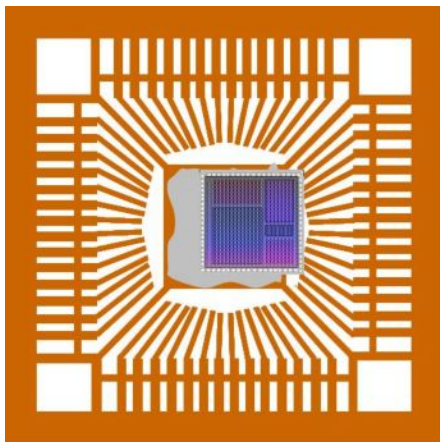


写真5



語群			
写真	不良名称	原因工程	発生原因
1	DAF付着	他工程	接着剤のバリ付着
2	チップなし	自工程	チップの吸着エラー
3	不良チップマウント	自工程	不良マーク認識ミス
4	パッド汚染	他工程	ダイシング洗浄異常
5	チップ破れ	自工程	フレーム搬送ミス

SAMPLE